**关键元器件列表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **关键件名称**  **（填写中文）** | **型号** | **规格** | **制造商** | **备注** |
| 1 | 芯片 | BL602C-20-Q2I | WIFI\_BT IC QFN32\_4\*4mm | 博流 |  |
| 2 | 晶振 | J3240000AA09AA | 晶振 40MHz 9PF ±10PPM SMD 3225 -40~+85度 | 晶创芯 |  |
| 3 | 电容 | C0201C0G2R2B500NTA | SMD陶瓷电容 2.2pF,50V,B(±0.1PF),C0G,0201 | 宇阳 |  |
| 4 | 电感 | SDCL0603Q1N8ST02 | 贴片电感 1.8nH ±0.3nH 300mA 0201 | 顺络 |  |
| 5 | PCB | ELINK-WM09-REV02-2021101 | PCB 沉金,双层板 | 祺利 |  |
| 6 | 天线 | ELINK-WM09-REV02-2021101 | PCB 沉金,双层板 | 祺利 |  |
| 7 |  |  |  |  |  |

注：请按照无线模组，晶振，天线，放大器，滤波器等这些跟射频有关的器件来列，如果有些不确定的，都列上去，主要是无线模组的一定要有。

天线（必写）；  
无线模组/芯片/主控/模块（填其中一个）